(9) 日本国特許庁 (JP)

① 特許出願公開

⑫ 公開特許公報 (A)

昭59—184745

⑤ Int. Cl.³
C 03 C 17/36
C 08 J 7/04

// C 23 C 15/00

識別記号

1 0 4

1 0 3

庁内整理番号 8017-4G 7446-4F

7537-4K

79発

⑪出

明 者

❸公開 昭和59年(1984)10月20日

発明の数 1 審査請求 未請求

ディーター・ミユラー

ドイツ連邦共和国5900ズイーゲ

ン21ビルレンバハー・シユトラ

ドイツ連邦共和国8510フユルト

・オツトー・ゼーリング・プロ

人 フラツハグラース、アクチエン

(全 5 頁)

郊透明な基体にコーティングを行う方法

20特

願 昭59-54600

22H

昭59(1984)3月23日

優先権主張 ②

③1983年 3 月25日③西ドイツ

(DE) ③ P3310916.8

②1983年5月6日③西ドイツ

(DE) ③ P3316548.3

切発 明 者 ロルフ・グロト

ドイツ連邦共和国4630ボーフム

6 ホルツシユトラーセ218

1983年 5 月 6 日 39四 下 1

⑭代 理 人 弁理士 田代烝治

ーセ189

ゲゼルシヤフト

メナーデ10-14

명 쉐 된

1. 発明の名称 透明な悲体にコーティングを行う 方法

2.特許請求の範囲

(1)多層光学フィルタが、少なくとも1つの銀層および外方へこれに続いて配置された酸化すずから成る反射防止層を有し、その際反射防止層は、所定の反射防止層酸素分圧(B分圧)および所定の反射防止層酸布速度(B酸布速度)でマグネトロン陰極スパンタリングにより形成される、多層光学フィルタを有する透明な基体にコーティングを行う方法において、

銀居上にマグネトロン陰優スパッタリングにより、まず反射防止層よりも薄い金属酸化物の保護層を取付け、しかも E 分圧よりも低い保護層酸素分圧(S分圧) および E 阪布速度よりも低い保護層版布速度(S阪布速度)で取付け、またその後保護層上に反射防止層を取付けることを特徴とする、透明な基体にコーティングを行う方法。

(2) 金属酸化物保護層をリアクティブマグネトロ

ン陰極スパッタリングによつて取付ける。特許請求の範囲第 / 項記載の方法。

(3) すず、インジウム、すずをドーピングしたインジウム、鉛、亜鉛、チタン、タンタルのうち 1 つの物質から成るターゲットにより金属酸化物保設層を形成する、特許開求の範囲第 2 項記報の方法。

(4) 例えば酸化すず、酸化インジウム、酸化すずをドーピングした酸化インジウム、酸化鉛、酸化 連鉛、酸化チタンまたは酸化タンタルのうち1つの物質から成る金属酸化物ターゲットにより金属酸化物保護層を形成する、特許請求の範囲第 / 項記載の方法。

(5)保護層をS分正およびS散布速度で取付け、 これらS分圧とS散布速度が、E分圧またはE散 布速度の高々性質 0.5 倍である、特許請求の範囲 第1項~第4項の1つに記載の方法。

(3) 50 Åない し 300 Åの 照 原 を 有 す る 譲 居 上 に . 20Å ない し 100 Å の 原 さ に 保 護 居 を 取 付 け . こ の 保 護 暦 上 に . 250 Å ない し 600 Å の 原 さ に 反 射 防

特開昭59-184745(2)

止層を取付ける、特許請求の範囲第/項~第5項 の1つに記載の方法。

(7)保護層を、3×10⁻⁴ mbar またはそれ以下のS分EおよびBA/sec またはそれ以下のS散布速度で取付け、かつ反射防止層を、7×10⁻⁴mbar またはそれ以上のE分Eおよび20A/sec またはそれ以上、例えば35A/sec ないし 40A/sec のE 散布速度で取付ける、特許請求の範囲第6項記級の方法。

3. 范明の詳細な説明

本発明は、多層光学フィルタが、少なくとも1つの銀層および外方へこれに続いて配置された観化すずから成る反射防止層を有し、その原反射防止層は、所定の反射防止層酸器分圧(E分圧)および所定の反射防止層酸布速度(E改布速度)でマグネトロン陰極スパッタリングにより形成される、多層光学フィルタを有する透明な翡像にコーティングを行う方法に関する。

銀層は、種々の方法で取付けることができ、例えば実際にはマグネトロン陰極スペンタリングに

よつて行われる。反射防止層は、例えばリアクテ イプマグネトロン監備スパツタリングによつて収 付けられる。この方法は、必要ではないがほとん どの場合、通過ゲート装置を用いて行われる。基 体は、ガラス収またはプラスチック仮であつても よい。薄い銀原は、赤外線ピームに関する大きな 反射率に関連して大きな光透過量の点で優れてお り、かつそれにより例えば窓の熟線阻止を改整す るため強々の用途を有する。銀灯のこれら選択特 性は、基体から離れたガの銀層の面に、 1.7 以上 の屈折率を有する誘電体材料から成る可視領域に 合わせた反射防止層を配置すると、さらに改善で きる。このようなフイルタの別の実施形態によれ は、透明装体と銀層の間に別の誘電体層が設けら れており、この層は、付滑媒体として使われ、か つ好波段の層として形成した際、付加的になお反 射筋止効果も生じる。それ故に初めに述べたよう な処置の静内において、悲体と銀層の間に1つま たは複数の別の金属酸化物層が取付けられるよう になつている。反射防止層は、1つまたは複数の

付加的なマスキングミラー層を有することもでき る。さらに初めに述べた処職の権内において、付 治強度を改善するため、透明基体と銀層の間およ び金属酸化物層と銀層の間に、例えばクロム、二 ツケル、チタン、クロム・ニツケル合金から成る 金属層または合金層を配置するようになつている。 そのためわずかな原子層の厚さしかない公知の槭 めて薄い層で十分である(ドイツ運邦共和國特許 出顧公開第 2144242 号明細 豊谷照)。マグネトロ ンスパッタリング (米国特許第4013532 号明細書)においては、高いコーテイング速度の点で優れ ている真空法が使われる。この方法によれば、銀 層と比較して比較的限い反射防止層の製造が特に 経済的に可能である。その際反射防止層の製造の ため、特に酸化すずを問題とする場合、リアクテ ィブマグネトロンスパツタリング法が適用される。 酸素を含むガス雰囲気中で金属または合金ターゲ ツトがスパンタリングされ、その際反応過程によ り基体上に企民酸化物または混合金国酸化物の局 が生じ、この層は、誘電体反射防止層として働く。 次に用語を簡単にするため、ここで定義する略語 について説明する。すなわちビ分圧とは、反射防止局 酸素分圧を表わし、E散布速度とは反射防止 層 散布速度を表わす。

初めに述べたような経験的に周知の方法を実施する際、酸素を含んで反応性ブラズマ中においいない。 世層に反射防止層を取付けることにより銀層の赤外線反射特性が悪化することがわかつた。 すなわちではないが、一般には一般には、一般には、一般には、一般には、一般により、一般により、一般により、一般による。 反射防止層にのよいない、の効率が悪による銀層のこの変化の原因はわかっていない。

本売切の課題は、銀層の赤外線反射特性の悪化 がもはや生じることのないように、しかもリアク

特開昭59-184745(3)

テイプマグネトロン 陰極スパックリングにより 反射防止層の取付けを行つた場合にさえ生じることのないように、初めに述べた方法を改善することにある。

この課題を解決するため、本範則は次のことを 示している。すなわち銀層上にマグネトロン陰欄 スパツタリングにより、まず反射防止層よりも薄 い金属酸化物の保護層を取付け、しかもE分圧よ りも低い保護層酸素分圧(8分圧)およびE散布 速度よりも低い保護層散布速度(S散布速度)で 取付け、またその後保護層上に反射防止層を取付 ける。本発明の有利な実施形によれば、金属酸化 物保護層はリアクテイプマグネトロン陰礙スパッ タリングにより取付けられる。その際企材酸化物 保護層は、すず、イシジウム、すずをドーピング したインジウム、鉛、亜鉛、チタン、タンタルの うち1つの物質から成るターゲットによつて形成 でき、かつ酸化すず、酸化インジウム、酸化すず をドーピングした酸化インジウム、酸化鉛、酸化 亜鉛、酸化チタンおよび酸化タンタルから成る。

本発明の別の提案は次のような特徴を有する。すなわち愈財政化物層は、例えば酸化すず、放化インジウム、酸化すずをドーピングした酸化インジウム、酸化結、酸化亜鉛、酸化チタンまたは酸化タンタルのうち1つの物質から成る愈財酸化物ターゲットを用いたマグネトロン陰儼スパッタリングによつて形成される。

本発明の枠内において反射防止層については、前記構造の光学フィルタを有する基体のコーティングの原に通常の層厚で作業を行う。保護層の厚さおよびS分圧およびS散布速度は、広い範囲に可変である。標準値は次のような特徴を有する。すなわち保護層は、B分圧またはE散布速度の高なの、60.5倍のS分圧およびS散布速度で取付けられる。細部において本発明は次のことを示している。すないし100~Aの厚さの保護層を取付け、かつ設とでいた。20~Aの厚さの保護層を取付け、かつ設とではで、250~Aの厚さの保護層を取付け、かの設とで、公保護層上に、250~Aの厚さの保護層を取付ける。これに関連ですから成る反射防止層を取付ける。これに関連、して本発明の有利な実施形は次のような特徴を

する。すなわち保護層は、3×10⁻⁴ mbar または それ以下のS分圧および B Å / sec またはそれ以 下のS 散布速度で取付けられ、また反射防止層は、 7×10⁻⁴ mbar またはそれ以上のE分圧および20 Å / sec またはそれ以上の、例えば 35 Å / sec な いし 40 Å / sec のE 散布速度で取付けられる。

本発明は次のような知識を前提としている。すなわち公知の処理の権内において反射防ロンを腐ける際、例えばリアクティブマグネトロンを依てスペッタリングの際の反応プラズマによれた。これらの最上層にとじ込められ、これらを原子が、初めに述べた妨害が変化を引きるとに銀度でよる。保護層の取付けによる銀層の損傷を防止する。おりの取付けによる銀層の損傷を防止する。おりの取付けの際にリアクティにでは、保護層の取付けによる銀層の限にリアクティになり、大力のである。保護層の保護作用のためにはすでに20人の原原で十分であることがわかつた。通過ゲート

装置に本発明による方法を適用した際保護層を取 付けるための陰極を銀陰極と反射防止層用の陰極 との間に配置すると有利であり、その際コーティ ングすべき基体は、順にこれらスパッタリング位 置を通過する。本発明は、通過法による動作に限 定されるものではない。すなわち保護層と反射筋 止層は同一陰極により顧に取付けてもよく、その 際コーテイングパラメータは、保護層を取付けた 後に反射防止層取付けのための要件に合わせて設 定変更しなければならない。保護層を製造する際 一般にスパックリングに適当な企民または合金の ターゲットを使用する。しかし酸化物ターゲット を使用してもよい。これら酸化物ターゲットでは、 金国ターゲットにおけるものより低い設布 速度は あるが、保護層に必要な数A/ sec の速度は容易 に得られる。耐化物ターゲットを使用すれば、明 観光に対して妨害となる残留吸収のない酸化物原 を形成するため必要なコーティング室内の酸素圧 力は、金属ターゲットを使用した場合よりも低い という利点が得られる。それにより銀灯の損傷を

特開昭59-184745 (4)

·研ぐため、許容最大敵素圧力に対する安全度が高 まる。

次に木発明の実施例について説明する。

例 1

次のような層を順に取付けた。

- ・すすのリアクテイブスパツクリングによる 330 Åの破化すず層
 - 90 %の In と10%すずの合金のリアクティブ

続いてすずターゲントのリアクティブスパンタリングにより、 30 Å の厚さの SnO_2 層を取付けた。スパンタリングは、 1×10^{-4} mbar の S 分圧における Ar / N_2 / O_2 の影明気で、 3 Å / sec の S 敬 布速度で行つた。

これに続いて 1.4 × 10⁻³ mbar の B 分胚における Ar/N₂ / 0₂ の雰囲気で、 35 Å/ sec の散布速度で別の酸化すず層によるコーティングを行つた。

コーティングの空気側からコーティングした板の赤外線反射罩を測定し、 A == 8 /m において 92 %の反射率が得られた。5500 Å における透過率は84 %であつた。

例日

スパッタリングによる40 nの厚さの酸化すずドー ピング酸化インジウム層

(これち2つの層は、いつしよになつてガラス 担体と銀層の間に配置された第1の反射断止層を、 形成し、この反射防止層は付着層としても動く。)

・ アルコンの雰囲気中の銀のスパツ々リングに よる80 Å の厚さの銀層

続いて銀層上にすずターゲットのリアクティブスパッタリングにより 400 Åの厚さの酸化すず層を取付けた。放布速度は 35 Å/secである。スパッタリングは、Ar/k/Q の雰囲気で行い、その顔モ分圧は、1.4 × 10⁻³ mbar であつた。

: 引続きコーテイングの空気調からビームを人射 してコーテイングした板の赤外線反射率を測定し. в µm の波段で 12 %の反射率が得られた。5500 х における板の透過率は51%であつた。

例Ⅱ

例)と同様にまずフロートガラス板上に、330 A の酸化すず層、40 A の酸化すずドーピング酸、 化インジウム層、および80 A の銀層を取付けた。

であつた。

これに続いて 1.5×10^{-3} mbar の E 分比における $\Lambda r/N_2/O_2$ の雰囲気で、 35 %/ sec の E 散布速度で 360 % の厚さの酸化すず層によるコーティングを行つた。

コーティングした板の A = 8 /m における赤外線 区射率は 92 %. かつ 5500 Å における透過率は 84.5% であつた。

図は、本発明によりコーティングしたガラス板 の透過率と反射率を示す図である。



